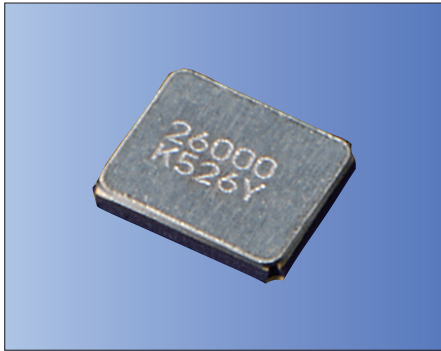


表面贴装型 CX2520DB (消费类电子产品应用/移动通信应用)

2.5×2.0mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 消费类电子产品应用·移动通信应用晶体谐振器
- 陶瓷封装
- 可对应回流焊

■用途

- 数字家电
- 消费类电子产品
- 移动通信、Bluetooth®、无线LAN

※Bluetooth®是Bluetooth SIG Inc.(美国蓝牙公司)的注册商标。

■型号表示方法

CX2520DB 27000 D0 G □ J CC  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称

②频率

③负载容量

D0 8 pF

④频率容差  
(常温偏差)

G ±15×10<sup>-6</sup>

⑤工作温度范围以及⑥频率温度特性

EJ	-10 ~ +70 °C	±15×10 <sup>-6</sup>
LN	-30 ~ +85 °C	±25×10 <sup>-6</sup>

⑦个别规格(产品目录以CC标示)

包装方式(载带包装 1000/ 3000/ 12000个/ 卷盘)

■规格

项目	记号	标准规格	单位	备注
频率	f <sub>nom</sub>	12000 ~ 54000	kHz	
泛音次数	OT	Fundamental	—	
负载容量	CL	8	pF	其他负载容量, 敬请咨询。
频率容差	f <sub>tol</sub>	±15	×10 <sup>-6</sup>	25° C ±3° C
串联电阻	R1	Table 1	ohm	
激励级	DL	Table 2	μW	
工作温度范围	T <sub>use</sub>	-10 ~ +70	°C	-30 ~ +85
储存温度范围	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +85	°C	
频率温度特性	f <sub>tem</sub>	±15	×10 <sup>-6</sup>	对于25° C频率的偏差

以上规格为规格示例, 如需其他规格, 敬请咨询。

■Table1 串联电阻

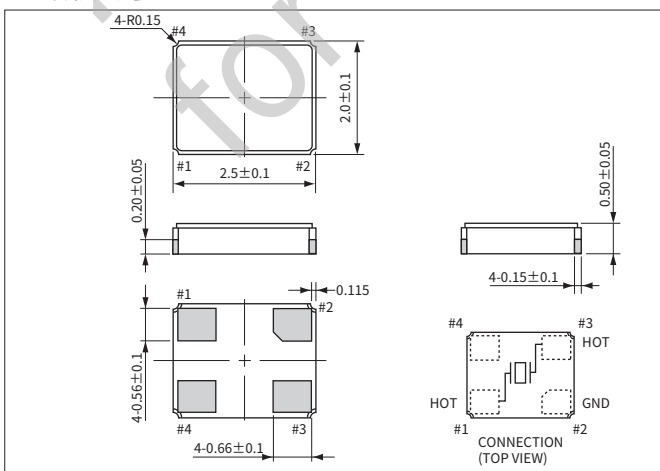
频率范围	串联电阻
12000 ≤ f <sub>nom</sub> < 16000 kHz	150Ω max.
16000 ≤ f <sub>nom</sub> < 26000 kHz	80Ω max.
26000 ≤ f <sub>nom</sub> < 30000 kHz	60Ω max.
30000 ≤ f <sub>nom</sub> ≤ 54000 kHz	50Ω max.

■Table2 激励级

频率范围	激励级
12000 ≤ f <sub>nom</sub> ≤ 54000 kHz	10μW (100μW max.)

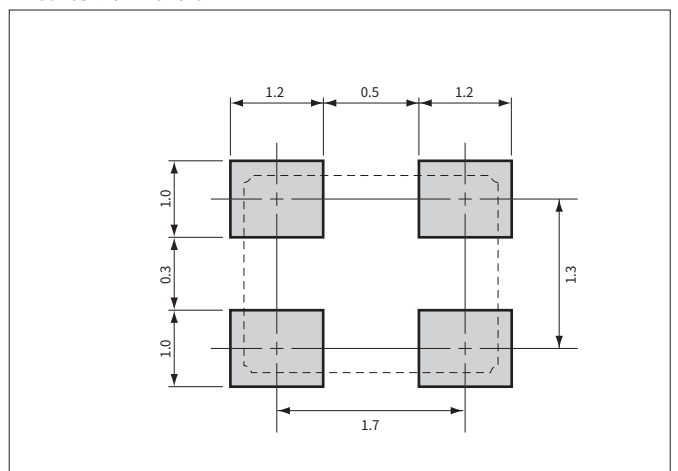
■外形尺寸

(单位 :mm)



■推荐焊盘图案

(单位 :mm)



截至2019年12月